

证券代码：688603

证券简称：天承科技

## 广东天承科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参会单位	平安银行、中金资管、中信保诚基金、远海基金、方正资管、证国基金、东吴基金、IGWT Investment、华安财保资管、新华基金、野村资管、金光紫金创投、金之灏基金、鼎睿资管、瀚伦基金、递归资产、华杉投资、巨子基金、域秀投资、英谊资管、贵源投资、勤辰基金、伟晟投资、大家资管、川流基金、华鑫证券、方正证券、长城证券、华金证券、民生证券、财通证券、浙商证券、华金证券、德邦证券、中信证券
调研时间	2024年10月30日（周三）15:30-16:30
会议形式	线上会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：费维 CTO、半导体业务负责人：韩佐晏 财务负责人：王晓花
投资者关系活动主要内容记录	<p>（一）请问公司2024年前三季度的经营情况如何？</p> <p>答复：</p> <p>根据 PrismaMark 最新的报告，2024 年全球 PCB 行业呈现出结构分化的复苏态势，预计全年产值将达到 733.46 亿美元，同比增长 5.5%。基于天承科技的研发沉淀和产品覆盖度，我们可以充分享受结构化复苏带来的红利。一如既往，天承科技从业务端整体呈现稳健且持续增长的发展态势。</p> <p>具体来看，公司前三季度的产品销售量同比去年有不错的提升，</p>

从出货量的角度，公司整体出货量同比提升了超过 33%，其中电镀添加剂的增幅更加明显，另外核心产品水平沉铜专用电子化学品出货量也稳步提升。

公司产品毛利率整体呈现稳步上升的趋势，单季度来到 40%，今年整体来到 39%。

在持续对团队扩张、集成电路领域加大投入的情形下，公司有史以来首次实现单季度盈利超过 2000 万元，同比提高超过 32%。

公司 2024 年持续扩张，管理费用、销售费用、研发费用方面均有所增长，长期来看，公司为未来的快速发展做好了各项准备。

## **（二）请问公司目前出海的进展如何？**

答复：

公司今年上半年搭建了海外平台，同时 ODI 已经取得上海市商务委、发改委的批复。近期已开始向定颖、奥特斯等公司核心客户的东南亚工厂少量出货。

公司海外平台搭建的目的包括产品的出海以及海外的投资布局和技术、产品合作。目前，公司主要出口 PCB 相关产品，后续还会陆续将泛半导体类产品对全球进行销售。公司的目标也是打造一家国际化的平台型材料龙头企业。

## **（三）请问玻璃基板相较于 FCBGA 的优势是什么，二者未来会呈现什么趋势？**

答复：

从去年 Intel 发布的消息以后，玻璃基板一直是行业里的高热度话题。玻璃基板的优点在于其是高介电常数与低介电损耗，高平整度与低粗糙度，以及热稳定性与低热膨胀系数。随着玻璃通孔激光诱导蚀刻技术和孔金属化技术的逐渐成熟，使得该技术路线在先进封装中得到了实现。相信玻璃基板和 FCBGA 技术在未来会达到齐头并进，共同发展的格局。

**（四）请问公司拟将上市主体迁移至上海的原因是什么？**

答复：

近年来，公司在持续推动 PCB 电子化学品业务增长的同时，也在不断吸纳集成电路方面的优秀科研人才，并加大先进封装、先进制程等集成电路相关材料的研发投入，积极拓展产品应用领域，努力实现把公司功能性湿电子化学品在 PCB（含封装基板）全覆盖的能力拓展到半导体芯片领域。

上海是国内发展集成电路的制高点，浦东是上海发展集成电路的桥头堡。支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。天承科技希望能与国家发展改革、科技创新紧紧相连。

基于此，公司在审慎研究后，决定将注册地迁至上海，以期充分利用上海丰富的集成电路产业政策、集成电路产业资源和优秀的集成电路产业人才等地区优势为国家的集成电路事业做出更大贡献。

**（五）请问公司拟将上海集成电路协会副秘书长石建宾作为新增独立董事的原因是什么？**

答复：

石秘书长为上海市集成电路行业协会副秘书长，上海市经信委、浦东新区科经委等政府单位项目组专家。熟悉上海市集成电路产业政策，主持编写过多项集成电路产业政策、产业咨询报告及规划。自 2014 年开始，连续 9 年参与编写《上海集成电路产业发展研究报告》。

鉴于公司当下正重点布局集成电路材料领域，石秘书长作为新增独立董事，将会助力公司了解产业政策，获取产业资源，加速公司集成电路领域的拓展进度和力度。

**（六）请问公司先进封装领域的电镀添加剂目前验证进展如何？**

答复：

公司先进封装的产品主要聚焦于电镀铜柱、再布线层、硅通孔和玻璃通孔填孔电镀等产品，相关的产品和技术已经完成配方开发、并

持续在下游客户产线验证，目前获得的测试结果都较好，符合客户的预期。韩博带领的团队针对未来 3-5 年的产品规划思路清晰，当前公司针对不同产品有策略地进行推进。

**（七）请问公司当下的战略规划如何？**

答复：

公司在 PCB 配方型电子化学品领域已经成为国内核心供应商。随着 CTO 韩博领衔的半导体事业部的组建和二期工厂建设完成，公司现已从 PCB（含封装基板）全覆盖的能力拓展到了先进封装和晶圆级电镀领域。

随着天承科技集成电路新板块的成型，韩博士与核心管理层也已经在探索天承科技新的公司组织架构，包括中央研究院的机构设置，包括数个泛半导体 BU 的成立。公司积极引进国内外顶尖人才，以自主创新为驱动力，不断挖掘功能性湿电子化学品的潜力，拓宽产品于多种应用领域，如面板、新能源等，构建功能性湿电子化学品的自主品牌，为客户解决关键技术难题，持续为行业提供“进口替代”的新方案。

公司始终坚持“高端专用湿电子化学品添加剂”的定位，逐步推动公司成为一家综合型、平台型、国际化的半导体材料龙头上市公司。

公司希望将天承科技建造成一个可以持续吸引高端人才、团队的平台，让企业文化沉淀下来，从而让平台持续焕发活力。

附件清单	无
日期	2024 年 11 月 1 日